

プラナリゼーション CMP とその応用(1)

3月18日 8:40~10:20 D室

D00・D01 (キーノートスピーチ)

研磨パッド表面状態と研磨レートの関係—マクロモデルとマイクロモデル—

○磯部 晶 (九州大)

D02

革新的 CMP/P-CVM 融合装置の設計・試作 (第 1 報) —装置化の基本コンセプトと試作装置—

○土肥俊郎 (九州大) ・佐野泰久 (大阪大) ・黒河周平 (九州大) ・會田英雄 (九州大, 並木精密宝石)

D03

革新的 CMP/P-CVM 融合装置の設計・試作 (第 2 報) —基本型融合加工装置(A-type)とその基本特性—

○塩澤昂祐・佐野泰久 (大阪大) ・土肥俊郎・黒河周平 (九州大) ・會田英雄 (並木精密宝石) ・宮下忠一・住澤春男 (不二越機械工業) ・山内和人 (大阪大)

D04

革新的 CMP/P-CVM 融合加工装置の設計・試作 (第 3 報) —挑戦型融合加工装置 (B-type) とその基本特性—

○大山幸希 (並木精密宝石) ・土肥俊郎 (九州大) ・佐野泰久 (大阪大) ・黒河周平 (九州大) ・會田英雄 (並木精密宝石) ・塩澤昂祐 (大阪大) ・宮下忠一・住澤春男 (不二越機械工業)

プラナリゼーション CMP とその応用(2)

3月18日 10:40~12:00 D室

D06

河川礫に着目した研磨メカニズムの生産原論的考察—河川礫の摩擦・擦過作用に基づく機械的特性の分析と地層堆積場推定の試み—

畝田道雄・○今村友貴 (金沢工大) ・後藤道治 (福井県立恐竜博物館) ・増淵佳子 (富山市科学博物館) ・石川憲一 (金沢工大)

D07

SiO₂-CMP における材料除去メカニズムに関する研究—凝着挙動に関する定量的評価法の開発—

○高野祐一・福田孝佑・カチョーンルンルアンパナート (九工大) ・木村景一 (NTUST) ・鈴木恵友 (九工大)

D08

研磨パッド内部構造が及ぼす研磨性能への影響

○藤本圭一朗・宮本一隆・薄谷美由紀・尾形謙次郎 (ニッタ・ハース)

D09

ファイバードレッサによるパッドドレッシングの有効性の評価—ファイバードレッサの寿命評価—

畝田道雄・○高橋直紀（金沢工大） ・新井雄太郎（昭和工業） ・藤田 隆（東京精密）

プラナリゼーション CMP とその応用(3)

3月18日 13:00~14:20 D室

D13・D14 （キーノートスピーチ）

CMP 研磨レート分布に及ぼすウェーハエッジ形状の影響—ウェーハエッジロールオフとノッチに関して—

○福田 明（徳山高専）

D15

グリーンデバイス用結晶基板の加工プロセス技術の研究開発（第5報）—ダイラタンシー・パッドによる SiC 基板の加工面品位とその評価—

○山崎 努・瀬下 清・大坪正徳（九州大） ・柏田太志（フジボウ愛媛） ・土田秀一（電力中央研究所） ・土肥俊郎（九州大）

D16

グリーンデバイス用結晶基板の加工プロセス技術の研究開発（第6報）—高効率加工プロセス用高速圧加工装置—

○瀬下 清（九州大） ・宮下忠一（不二越機械工業） ・山崎 努（九州大） ・住澤春男（不二越機械工業） ・若林豊博・土肥俊郎（九州大）

プラナリゼーション CMP とその応用(4)

3月18日 14:40~16:00 D室

D18

レーザーアシスト延性加工によるシリコンの平坦化（第1報）—熱援用延性加工の基礎特性の確認—

○山信田博紀・武田秀俊・会田英雄（並木精密宝石）

D19

レーザーアシスト延性加工によるシリコンの平坦化（第2報）—微小押し込み高圧相の生成とその熱援用切削に対する効果—

○山信田博紀・武田秀俊・会田英雄（並木精密宝石）

D20

CMP における研磨装置の挙動解析と研磨特性との関係—Si-CMP に及ぼすスラリー砥粒濃度の影響検討—

畝田道雄・○高橋佳宏（金沢工大） ・澁谷和孝・中村由夫・市川大造（不二越機械工業） ・石川憲一（金沢工大）

D21

小径工具による高能率研磨に及ぼすスラリー流れの影響

○吉富健一郎・平井洋介・餅田正秋・宇根篤暢（防衛大）